

이 보고서는 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해 발간한 보고서입니다.

기술분석보고서

 YouTube 요약 영상 보러가기

# RF머트리얼즈(327260)

## 기타제조

요약  
기업현황  
재무분석  
주요 변동사항 및 전망



작성기관

NICE평가정보(주)

작성자

박현범 전문연구원

- 본 보고서는 「코스닥 시장 활성화를 통한 자본시장 혁신방안」의 일환으로 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해, 한국거래소와 한국예탁결제원의 후원을 받아 한국IR협의회가 기술 신용평가기관에 발주하여 작성한 것입니다.
- 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것이므로, 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대해서도 본회와 작성기관은 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 본 보고서의 요약영상은 유튜브로도 시청 가능하며, 영상편집 일정에 따라 현재 시점에서 미 게재 상태일 수 있습니다.
- 카카오톡에서 “한국IR협의회” 채널을 추가하시면 매주 보고서 발간 소식을 안내 받으실 수 있습니다.
- 본 보고서에 대한 자세한 문의는 작성기관(TEL.02-2124-6822)으로 연락주시기 바랍니다.

# RF머트리얼즈(327260)

통신/레이저/군수용 화합물 반도체 패키지 선도 기업

## 기업정보(2021/09/30 기준)

|      |                  |
|------|------------------|
| 대표자  | 한기우              |
| 설립일자 | 2007년 12월 28일    |
| 상장일자 | 2019년 12월 24일    |
| 기업규모 | 중소기업             |
| 업종분류 | 그 외 기타 전자부품 제조업  |
| 주요제품 | 통신, 레이저, 군수용 패키지 |

## ■ 고품질의 화합물 반도체 패키지 생산 기술 보유

RF머트리얼즈(이하 '동사')는 광 통신용, 레이저 모듈용, 군수 장비용 등에 이용되는 화합물 반도체 패키지를 제조하는 업체로, 화합물 반도체는 2가지 이상의 화학 원소가 더해진 화합물 형태의 반도체이다.

동사는 높은 기술력을 요구하는 적층 세라믹 제조 공정, 히트 싱크 제조 공정, 접합 공정(글라스 실링, 메탈라이징, 브레이징 접합)을 자체 개발하였다. 이러한 기술력을 기반으로 밀폐성(Hermeticity), 방열, 낮은 열팽창 계수, 내열성, 내구성 등 화합물 반도체 패키지에 필요한 성능을 모두 갖춘 제품을 생산하고 있다.

## 시세정보(2021/12/06 기준)

|            |           |
|------------|-----------|
| 현재가(원)     | 32,000    |
| 액면가(원)     | 500       |
| 시가총액(억 원)  | 1,280     |
| 발행주식수      | 3,998,849 |
| 52주 최고가(원) | 40,800    |
| 52주 최저가(원) | 18,400    |
| 외국인지분율     | 2.22%     |
| 주요주주       | 한기우       |

## ■ 꾸준한 투자로 매출 성장이 기대되는 기업

동사는 무선 통신 장비 제조 업체인 '알에프에이치아이씨씨'와 인수 합병을 통해 광 통신용 패키지의 안정적인 판매처를 구축하였으며, 지난 2020년에는 방산 업체인 '비앤씨테크(현 알에프시스템즈)'를 인수하여 방산용 유선 통신 부품의 판매 기틀을 다지는 등 성장이 기대되고 있다. 한편, 최근에는 고효율 레이저 다이오드 칩과 모듈 제조 관련 국책 사업에 참여하며 레이저용 사업의 영역을 넓힐 예정이며, 이를 통해 모기업이 추진 중인 전자소자용 질화갈륨(GaN) 기반 광전소자 분야와 연계할 계획으로 기술력 및 매출 성장에 시너지를 낼 수 있을 것으로 예상된다.

## ■ 기술 고도화로 첨단 산업 진출이 가능한 산업

반도체 기술의 발달로 반도체 패키지 활용 분야가 점차 확대되고 있으며, 이에 맞춰 동사는 히트 싱크 기술을 활용하여 전기 자동차 파워 모듈용 제품을 개발하였다. 또한, 이와 관련된 품질 인증(IATF 16949)을 획득하여, 자동차, 우주 항공 등의 첨단 산업으로의 진출 기회를 선점하고 있다.

## 요약 투자지표 (K-IFRS 연결 기준)

| 구분<br>년 | 매출액<br>(억 원) | 증감<br>(%) | 영업이익<br>(억 원) | 이익률<br>(%) | 순이익<br>(억 원) | 이익률<br>(%) | ROE<br>(%) | ROA<br>(%) | 부채비율<br>(%) | EPS<br>(원) | BPS<br>(원) | PER<br>(배) | PBR<br>(배) |
|---------|--------------|-----------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 2018    | 193          | 68.6      | 46            | 23.9       | 37           | 19.4       | 37.4       | 25.4       | 35.7        | 1,587      | 5,373      | -          | -          |
| 2019    | 162          | (15.9)    | 11            | 7.0        | 12           | 7.4        | 6.2        | 5.0        | 15.8        | 453        | 7,414      | 62.0       | 3.8        |
| 2020    | 182          | 12.4      | (6)           | (3.4)      | (2)          | (1.3)      | (2.2)      | (0.5)      | 80.9        | (171)      | 8,113      | N/A        | 3.5        |

## 기업경쟁력

### 반도체 패키지 전문 기업

- **화합물 반도체 패키지 분야 독보적 기술력 확보**
  - 반도체 패키지에 적용된 세라믹 기술 확보
  - 화합물 반도체 패키지 분야 국내 점유율 93%
- **꾸준한 연구개발과 폭넓은 기술 권리 보호**
  - 연평균 약 4.8%의 연구개발비를 통한 기술 개발 지속
  - 핵심 기술 특허를 지속적으로 출원, 등록하여 폭넓은 기술 권리 취득

### 차별화된 사업 전략

- **세분화된 제품 판매 전략**
  - 통신용, 레이저 모듈용, 군수용 등 다양한 분야의 반도체 패키지 생산
- **인수 합병을 통한 사업 시너지 효과 기대**
  - 군수용품 전문 업체 인수와 모회사의 주요 사업 분야 관련 기술 개발로 사업 시너지 효과 기대

## 핵심기술 및 주력 제품

### 우수한 기술력과 생산 시설

- **고신뢰성 반도체 패키지**
  - 고신뢰성과 고품질이 요구되는 다양한 분야의 화합물 반도체 패키지 생산
- **품질 인증 받은 안정적인 생산 시설**
  - ISO 9001, 16949 등 다수의 인증으로 품질과 안정성이 입증된 생산시설 보유

### 주력 제품



## ESG 현황

### Environment

| 항목            | 현황 |
|---------------|----|
| 환경 정보 공개      | ■  |
| 환경 경영 조직 설치   | ■  |
| 환경 교육 수준      | ■  |
| 환경 성과 평가체계 구축 | ■  |
| 온실가스 배출       | ■  |
| 에너지, 용수 사용    | ■  |
| 신재생 에너지       | ■  |

■ : 양호 ■ : 미흡 □ : 확인불가

### Social

| 항목            | 현황 |
|---------------|----|
| 인권보호 정책 보유    | ■  |
| 여성/기간제 근로자 근무 | ■  |
| 협력사 지원 프로그램   | ■  |
| 공정거래/반부패 프로그램 | ■  |
| 소비자 안전 관련 인증  | ■  |
| 정보보호 안전 관련 인증 | ■  |
| 사회공헌 프로그램     | ■  |

■ : 양호 ■ : 미흡 □ : 확인불가

### Governance

| 항목            | 현황 |
|---------------|----|
| 주주의결권 행사 지원제도 | ■  |
| 중장기 배당정책 보유   | ■  |
| 이사회 내 사외이사 보유 | ■  |
| 대표·이사회 독립성    | ■  |
| 감사위원회 운영      | ■  |
| 감사 업무 교육 실시   | ■  |
| 지배구조 정보 공개    | ■  |

■ : 양호 ■ : 미흡 □ : 확인불가

- > 환경 경영 조직을 설치하고 있지 않으나, 직원들을 대상으로 환경 보호에 대한 책임을 교육하고 있음.
- > 임직원 존중에 관한 보호 정책을 보유하고 있고, 여성 근로자가 근무하고 있으며, 공정거래/반부패 프로그램을 진행하고 있음.
- > 주주의결권 행사 지원제도와 중장기 배당정책을 보유하고 있고, 이사회 내 사외이사를 보유하고 있으며, 지배구조 정보를 공개하고 있음. 한편, 감사위원회는 운영하고 있지 않으나, 별도의 감사를 선임하여 감사 업무를 수행하고 있음.

\* 본 ESG현황은 나이스평가정보(주)가 분석대상 기업으로 입수한 정보를 요약 정리한 것으로, 분석 시점 및 기업의 참여도에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.

## I. 기업현황

### 화합물 반도체 패키지 분야의 국내 선도기업

동사는 화합물 반도체를 안전하게 회로에 안착시킬 수 있는 패키지 분야를 선도하는 국내 기업으로, 광통신용 패키지, 레이저 모듈용 패키지, 국방용 패키지 등 다양한 분야의 초정밀 소형 패키지를 생산하고 있다.

#### ■ 개요 및 사업 현황

동사는 2004년에 개인기업인 ‘메탈라이프’로 설립되어, 2007년에 ‘(주)메탈라이프’로 법인 전환 하였다. 이후, 2019년에 코스닥 시장에 상장되었고, 2021년 3월에 ‘RF머트리얼즈(주)’로 사명 변경하였다. 동사는 지난 2017년 10월 모회사인 ‘알에프에이치아이씨(주)’에 인수됨으로써, 안정적인 판매처를 구축하여 매출 성장의 기틀을 마련하였으며, 최근 급격한 성장세에 있는 방산사업 시너지를 극대화하기 위해 2020년 9월에 국내 최고의 군용 환경제어장치 공조 기술을 보유한 ‘알에프시스템즈(주)’를 인수하는 등 다방면의 화합물 반도체 패키지 선도 업체로서 입지를 다져왔다.

동사는 경기도 안산시 단원구 강촌로 소재에 본사를 두고 있으며, 알에프에이치아이씨(주), 알에프시스템즈(주)의 2개 업체를 계열회사로 두고 있다.

표 1. 계열회사의 현황

| 구분 | 회사명          | 업종                       | 상장여부     | 지분율                     |
|----|--------------|--------------------------|----------|-------------------------|
| 국내 | RF머트리얼즈(주)   | 전자부품, 통신부품 외 제조업         | 코스닥 상장법인 | 동사                      |
|    | 알에프에이치아이씨(주) | 통신기기 및 방송장비 제조업          | 코스닥 상장법인 | 37.43%<br>(당사 피투자, 모회사) |
|    | 알에프시스템즈(주)   | 절삭가공 및 유사처리업, 유선통신기기 제조업 | 비상장      | 60.84% (당사 투자)          |

\*출처: 3분기 보고서(2021), NICE평가정보(주) 재구성

#### ■ 보유기술 및 주요제품 현황

동사는 ‘적층 세라믹 공정’ 기술과 ‘단층 세라믹의 금속화 공정’ 기술을 확보하여, 일본 기업으로부터 전량 수입하던 화합물 반도체를 국산화에 성공하였으며, 밀폐구조로 패키지에 실장된 화합물 반도체에서 발생하는 열을 흡수하고 방출해 안정적으로 작동할 수 있게 하는 ‘히트 싱크 소재’ 기술을 확보하였다.

최근 화합물 반도체 패키지는 반도체 소자를 물리적으로 보호함과 동시에 전력 배선, 열 방출 등의 기능을 넘어 패키지 자체로 인해 발생하는 저항을 최소화하고, 상호 접속 기능/성능을

높여 반도체 소자의 기능을 극대화하는 방향으로 발전 중이며, 동사는 이 같은 패키지의 기능을 구현할 수 있는 기술을 확보하였다. 또한, 주목할 것은 동사가 핵심 기반 기술을 내재화함과 동시에 가격 경쟁력과 납기 경쟁력까지 확보했다는 부분이다. 가격은 경쟁업체 대비 최대 30% 저렴하면서, 납기는 60% 수준까지 기간을 단축하였다.

반도체 패키지 트렌드인 고출력, 고효율, 소형화를 위한 기본 조건에는 밀폐성, 방열, 저 열팽창 계수, 전기적 연결, 내열성, 내구성, 순금도금 표면 등이 있으며, 이를 만족하지 않을 경우 화합물 반도체 소자 자체의 출력 저하, 기능 상실문제가 발생하여 전자기기의 오작동으로 이어질 수 있다. 이러한 조건을 충족하기 위해, 동사는 브레이징(Brazing), 글라스 실링(Glass Sealing), 와이어 본딩(Wire Bonding), 용침(Infiltration), 신뢰성 평가, 써멀 매칭(thermal Matching) 등의 핵심 요소기술을 확보하고 있다.

**표 2. 동사의 화합물 반도체 패키지 핵심 요소 기술**

| 핵심 요소기술                     | 패키지 조건      | 정의  |
|-----------------------------|-------------|---|
| 브레이징<br>(Brazing)           | 밀폐성, 내열성    | 450도 이상에서 용가재와 열을 가하여 두 모재를 접합하는 고온 접합기술로 밀봉하는 공정에 해당               |
| 글라스 실링<br>(Glass Sealing)   | 밀폐성, 전기적 연결 | 글라스를 녹여서 금속이나 세라믹에 붙이는 방법, 밀봉하는 공정에 해당                              |
| 와이어 본딩<br>(Wire Bonding)    | 순금도금 표면     | 집적회로를 패키지의 리드(Lead)에 매우 가는 고순도 금(Au), 알루미늄(Al), 구리(Cu)선 등으로 연결하는 공정 |
| 용침<br>(Infiltration)        | 방열          | 히트싱크 소재인 MoCu/WCu 소재를 제조할 때 사용하는 기술                                 |
| 신뢰성 평가                      | 내구성         | 화합물 반도체 패키지의 내구성을 확인하기 위한 열 사이클 시험 및 열 충격 시험 등의 신뢰성 시험을 수행하는 공정     |
| 써멀 매칭<br>(Thermal Matching) | 저 열팽창 계수    | 화합물 반도체 소자를 보호하기 위한 저 열팽창 계수를 갖고 있는 소재로 제조하는 기술                     |

\*출처: 3분기 보고서(2021), NICE평가정보(주) 재구성

## ■ 제품 부문별 매출 실적

2021년도 3분기 보고서 기준, 동사의 매출 품목은 통신용 패키지, 레이저용 패키지, 군수용 패키지, 군수용 장비부품, 기타로 나뉘며, 통신용 패키지는 광 통신에 사용되는 반도체 패키지로서, GaN, GaAs, InP 등을 실장할 수 있고, 알에프에이치아이씨(한국), CREE(미국), LUMENTUM(미국) 등의 업체에 납품하고 있다. 레이저용 패키지는 산업용 및 의료용 기기의 레이저 모듈에 사용되는 반도체 패키지로서, GaAs, InP와 같은 화합물 반도체를 실장할 수 있으며, DILAS(독일), IPG(독일), TRUMPF(독일), 이오테크닉스(한국) 등의 업체에 납품하고 있다. 군수용 패키지는 적외선 영상 센서에 사용되는 패키지로, InSb, InGaAs 등의 화합물 반도체가 실장되고, I3SYSTEM(한국), SCD(이스라엘) 등의 업체에 납품하고 있다. 동사는 국내 판매의 경우 100% 직접 거래를 수행하고 있으나, 해외 판매의 경우는 대부분 대리점을 통해 이루어지고 있으며, 추후 광 PUMP 모듈 분야에서 세계시장을 선도하고 있는 JDSU, OCLARO, 3S-Photonics 등 글로벌 업체로의 진입을 통한 매출 증대를 목표로 하고 있다.

각 매출 품목의 2020년 매출 수준은 통신용 패키지 약 82억 원, 레이저용 패키지 약 10억 원, 군수용 패키지 약 9.2억 원, 군수용 장비부품 약 69.1억 원이며, 2021년 3분기 매출 수준은 통신용 패키지 약 62.7억 원, 레이저용 패키지 약 2.4억 원, 군수용 패키지 약 7.2억 원, 군수용 장비부품 약 176.4억 원으로 구성되어 있다. [표 3]에서 알 수 있듯이, 동사는 지난 2019년도까지 통신용 패키지가 전체 매출의 80% 넘는 비중을 차지하고 있었으나, 방산업체인 알에프시스템즈(주) 인수 등으로 인해 군수용품 매출이 크게 증가하였다. 그러나, 여전히 패키지 품목군 중에서는 통신용 패키지가 80% 이상의 비율을 유지하고 있다.

표 3. 매출 품목별 매출실적

(단위: 백만 원)

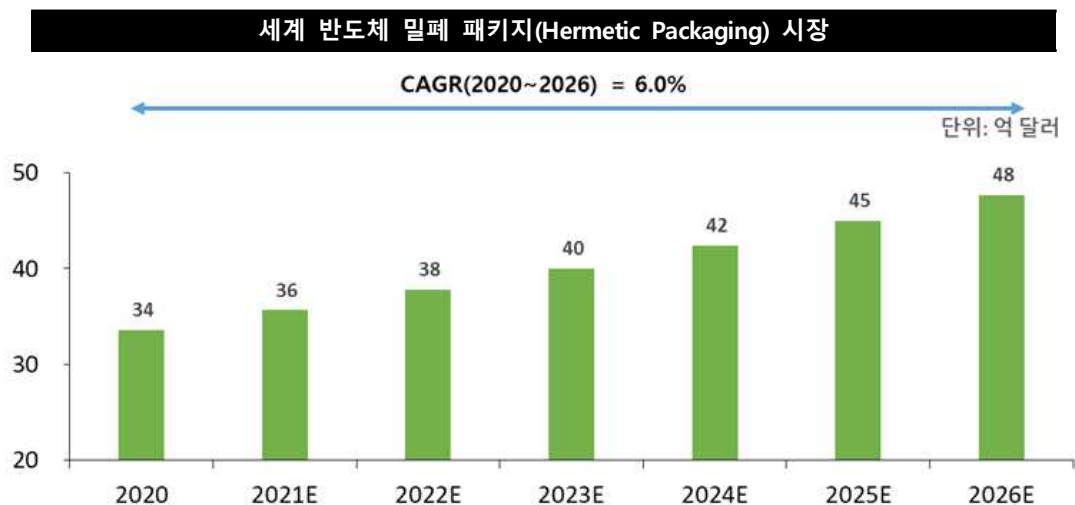
| 품목       | 2018년  | 2019년  | 2020년  | 2021년 3분기 |
|----------|--------|--------|--------|-----------|
| 통신용 패키지  | 16,036 | 13,638 | 8,203  | 6,271     |
| 레이저용 패키지 | 794    | 1,127  | 996    | 248       |
| 군수용 패키지  | 751    | 636    | 924    | 727       |
| 군수용 장비부품 | -      | -      | 6,918  | 17,641    |
| 기타       | 1,689  | 811    | 1,172  | 2,458     |
| 합계       | 19,270 | 16,212 | 18,213 | 27,345    |

\*출처: 3분기 보고서(2021), 사업보고서(2021), NICE평가정보(주) 재구성

## ■ 시장 현황

동사가 속한 반도체 밀폐 패키지(Hermetic Packaging)를 생산할 수 있는 국가는 일본, 미국, 프랑스, 독일, 중국 그리고 한국으로, 일부 선진국에서만 생산 기술을 가지고 있는 진입장벽이 높은 산업이며, 최근 레이저 산업, 군수 용품 등으로 활용 범위가 확대됨에 따라 수요도 다시 증가하기 시작했다. 한편, 360iResearch에서 발간한 시장 보고서인 'Hermetic Packaging Market Research' (2021)에 따르면, 세계 밀폐 패키지(반도체용) 시장은 2020년 34억 달러에서 연평균 6.0%(CAGR) 성장하여 2026년에는 48억 달러의 시장규모를 형성할 것으로 기대된다.

그림 1. 반도체 밀폐 패키지 세계 시장 현황



\*출처: 'Hermetic Packaging Market Research'(2021), 360iResearch, NICE평가정보(주) 재구성

## 프. 재무 분석

### 방산업체 인수를 통한 시너지 효과 가시화

동사는 2020년 말 방산업체 알에프시스템즈(주)를 인수하며 시너지 효과를 꾀하고 있으며, 인수 후 큰 폭으로 매출이 성장하였다.

#### ■ 자회사 인수효과로 매출 증가

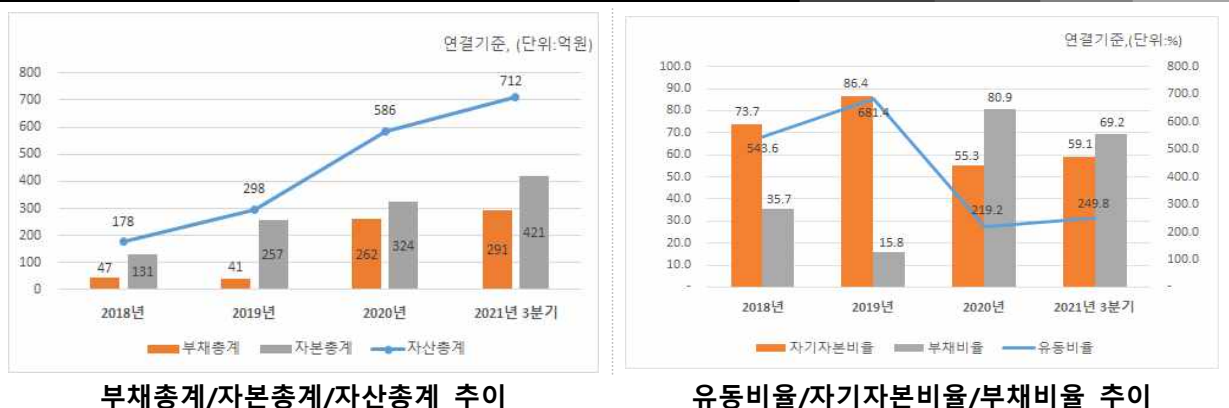
동사는 알에프시스템즈(주) 인수효과에 힘입어 2020년 연결기준 전년 대비 12.4% 증가한 182억 원의 매출액을 기록했다. 연결매출 182억 원 중 79억 원은 알에프시스템즈(주) 인수효과로 포함된 금액으로 당기 초부터 연결되었다면 포함되었을 매출액은 245억 원이다, 동사의 개별 매출은 2018년이 193억 원, 2019년이 162억 원, 2020년이 103억 원으로 통신용 패키지 위주로 감소세가 이어졌으나, 자회사 알에프시스템즈(주)의 매출은 2018년 156억 원, 2019년 215억 원, 2020년 245억 원으로 상반된 흐름을 나타내며 전체 매출 역성장을 방어해주었다.

그림 2. 동사 연간 및 3분기 요약 포괄손익계산서 분석



\*출처: 동사 사업보고서(2020), 분기보고서(2021)

그림 3. 동사 연간 및 3분기 요약 재무상태표 분석



\*출처: 동사 사업보고서(2020), 분기보고서(2021)

## ■ 수익성 하락하며 적자 전환

자회사 인수효과로 인한 매출 성장과 수익성 개선에도 불구하고 당기 매출액영업이익률은 -3.4%, 매출액순이익률은 -1.3%로 적자 전환되었다. 통신용 패키지 부문의 매출 역신장과 더불어 원재료 매입단가의 상승, 종업원 임금 상승이 주요 원인이었으며, 유무형자산 상각에 따른 비현금성 비용 증가도 일부 영향을 미쳤다. 당기 손익에 알에프시스템즈의 순이익 11억 원이 포함되었음에도 불구하고, 영업손실은 6억 원, 당기순손실은 2억 원을 각각 기록하였다.

## ■ 2021년 3분기 실적은 순항, 12/2 무상증자결정

2021년 3분기 연결기준 매출액은 알에프시스템즈(주) 인수효과가 온전히 반영됨에 따라 274억 원(+228.5% YoY)으로 급증했다. 통신용 패키지 사업부를 비롯한 동사의 개별 실적은 여전히 적자를 벗어나지 못했지만, 군수용품 부문의 우수한 수익성에 힘입어 영업이익 7억 원, 분기순이익 0.4억 원으로 흑자 전환했다. 동사의 개별기준 영업손실은 17억 원, 분기순손실은 12억 원을 각각 기록했다.

2021년 3분기 말 기준 부채비율은 69.2%, 자기자본비율 59.1%로 전기 말 부채비율인 80.9%, 자기자본비율 55.3% 대비 개선되었다. 부채 구조는 전기 대비 큰 변동이 없었으나, 전환사채 전환권 행사 및 주식선택권 행사, 종속기업 비지배지분 증가 등으로 자기자본이 324억 원에서 421억 원으로 증가한 영향이다. 분기 말 현금성자산 및 단기금융자산은 291억 원으로 유동부채 179억 원을 전액 상환하고도 충분한 수준이었으며, 유동비율의 경우 249.8%로 NICE 산업평균인 150.4% 대비 양호했다.

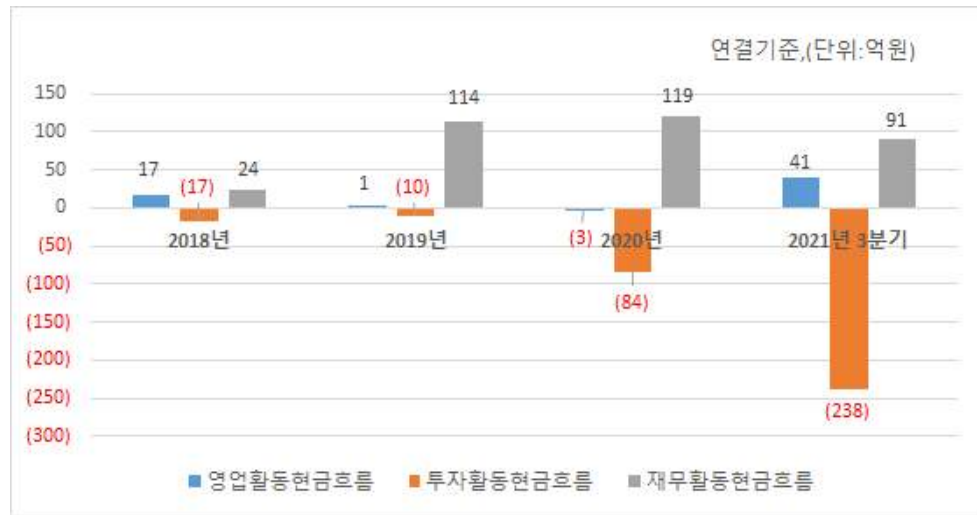
동사는 2021년 12월 2일 1:1 무상증자결정을 공시했으며 배정기준일은 12월 20일로 기존 4,023,848주가 무상증자 후 8,047,696으로 증가할 예정이다.

## ■ 비영업부문 자금 조달을 통한 현금흐름 유지

동사의 최근 영업활동 현금흐름을 살펴보면 2018년이 17억 원, 2019년 1억 원, 2020년 -3억 원, 2021년 3분기 41억 원으로 다소 부진했다. 동사는 사업 확장을 위해 설비 취득에 상당한 투자를 하고 있으며, 금융상품 매매와 같은 투자활동이 꾸준하여 영업창출현금만으로 원만한 자금흐름을 유지하기 어렵다. 따라서 전환사채 발행을 통해 자금의 대부분을 조달하고 있으며, 이 외 주식선택권 행사와 같은 자본거래로 자금 부족분을 채우고 있어 자본조달비용이 증가하고 있는 점은 유의가 필요하다.



그림 4. 동사 현금흐름의 변화



\*출처: 동사 사업보고서(2020), 분기보고서(2021)

## Ⅲ. 주요 변동사항 및 전망

### 매출 향상을 위한 사업 확장 및 기술 개발/장치 투자

동사는 방산 관련 사업 분야 시너지 확보를 위해 기술력이 높은 방산 업체를 인수하였으며, 고출력 레이저 기술 개발을 위한 국가 연구개발 과제 참여와 제품 수요 증가 대비를 위한 설비 투자를 확대하는 등 매출을 향상시키기 위한 투자를 지속하고 있다.

#### ■ 방산 전문업체 인수

동사는 지난 2020년 9월, 방산사업 시너지를 극대화하기 위해 군용 환경제어장치 공조기술을 보유한 ‘비앤씨테크(주)(현 알에프시스템즈(주))’를 인수하였다. 피인수 기업인 비앤씨테크(주)는 국내 최고의 알루미늄 DIP 브레이징 기술 및 군용 환경제어장치 공조 기술 등을 보유한 기업으로, 각종 항공기 및 유도탄용 레이더 안테나 관련 제품을 생산하고 있으며, 전투무선체계, 무인항공기 초소형 영상레이더 사업 등 다양한 레이더 방산 사업 분야에 참여하고 있다. 이에 동사는 인수 초년도인 2020년에 매출 품목 중 군수용 장비부품의 매출 비중이 약 38%에 달했으며, 2021년 3분기에는 약 176억 원(매출 비중 약 64%)을 달성하는 등 기존의 주력 사업인 패키지 분야의 매출을 뛰어넘는 실적을 기록하고 있다. 이러한 시너지 효과는 추후 모회사인 알에프에이치아이씨(주)가 진행하는 레이더 시스템 사업에서도 긍정적인 것으로 예상된다.

#### ■ 고출력 레이저 국산화 과제 선정

동사는 지난 5월, 산업통산자원부가 주관하는 ‘산업용 고출력 레이저 다이오드 칩과 모듈 제조기술 국산화 과제’에 선정되었다. 레이저 다이오드는 광통신, 라이다(LiDAR), 레이저 가공 설비, 의료 장비 등 다방면에 사용되는 부품이며, 고출력 레이저 다이오드의 경우, 그동안 전량 수입에 의존해 왔다. 본 과제는 고출력 레이저 다이오드를 국산화할 수 있도록 총 170억 원 규모의 정부지원금을 받는 과제로, 수 kW급 고출력 레이저 다이오드 모듈을 개발하는 것이 목표이며, 동사의 모기업이 추진하고 있는 전자소자용 질화갈륨(GaN) 기반 광전소자 분야가 연계되어 있어, 추후 큰 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대된다.

#### ■ 생산 설비 투자

동사는 향후 확대되는 통신 산업인 5G용 패키지에 사용되는 적층 세라믹의 수요와 알에프시스템즈(주)로부터 발생하는 군수용 장비 부품의 수요가 각각 크게 증가할 것으로 예상하고 있다. 이에 동사는 제품 생산 및 임가공과 관련된 기계장치에 2019년 사업보고서 기준 약 11억 원, 2020년 사업보고서 기준 약 9억 원, 2021년 3분기 보고서 기준 약 17억 원을 투자하는 등 매년 발생하는 기계장치의 감가를 상회하는 투자를 이어가고 있다.

표 4. 연도별 기계장치 증가액

(단위: 백만 원)

| 연도          | 2021년 3분기 | 2020년 | 2019년 |
|-------------|-----------|-------|-------|
| 기계장치 자산 증가액 | 1,697     | 978   | 1,127 |

\*출처: 3분기 보고서(2021), 사업보고서(2020), 사업보고서(2019) NICE평가정보(주) 재구성

## ■ ESG 활동 현황

ESG는 기업의 비재무적 요소인 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 뜻한다. ESG 평가는 기업엔 지속 가능 경영의 동기를 유발하고 투자자에게는 사회적 책임 투자에 대한 접근성을 제고하는 지표로 활용할 수 있다. 국내 ESG 평가를 수행하고 있는 기관은 한국기업지배구조원, 서스틴베스트, QESG가 있다.

환경경영 기준은 환경문제가 기업의 지속가능한 발전에 중요한 영향을 미치는 변수로 부각됨에 따라 제정되었고, 사회책임경영 기준은 지속가능경영에 대한 사회적 관심이 커지고 국제 자본시장에서 기업의 사회적 책임이 중요한 투자 의사 결정 고려요소가 됨에 따라 제정되었다. 또한, 기업지배구조 기준은 우리 기업의 투명성과 효율성을 제고함으로써 기업가치를 극대화하는 데 기여하는 것을 목적으로 제정되었다.

그림 5. EGS 모범기준 예시



\*출처: 한국기업지배구조원 홈페이지(2021)

공개 자료 및 질문지를 통해 ESG 항목에 대한 사항을 별도로 확인한 결과, 당사는 환경정보 공개, 환경 경영 조직 설치, 환경 성과평가체계 구축 등이 파악되지 않으나, ISO9001(품질경영시스템), IATF 16949(자동차품질경영시스템)를 보유하고 있고, 당사는 광 통신 모듈용 패키지와 자동차용 Power module 부품의 모범 기준을 일부 충족하고 있다.

표 5. 동사의 보유 인증 현황

| 인증명                     | 유효기간                     | 상태 |
|-------------------------|--------------------------|----|
| ISO 9001 (품질경영시스템)      | 2019.07.29. ~ 2022.08.13 | 유효 |
| IATF 16949 (자동차품질경영시스템) | 2019.07.02. ~ 2022.07.01 | 유효 |

\*출처: 한국생산성본부 인증원(2021), 동사 제공 자료, NICE평가정보(주) 재구성

동사가 취득한 품질경영시스템 인증(ISO 9001)은 해당 산업이 속한 분야에서 제품의 실현 시스템이 규정된 요구사항을 충족하고, 이를 유효하게 운영하고 있음을 인정하는 인증이며, 자동차품질경영시스템인증(IATF 16949)은 자동차 관련 제품 기업이 지속적 개선, 결함 예방 및 산포와 낭비 감소를 위한 요구사항을 만족하고, 일관성을 유지하고 있는 것을 확인하는 인증으로, 동사의 자동차용 Power module 부품이 IATF 16949의 규준을 충족하고 있다.

표 6. 보유 인증의 성격 비교

| 구분    | ISO 9001          | IATF 16949     |
|-------|-------------------|----------------|
| 규격 성격 | 품질경영시스템           | 자동차품질경영시스템     |
| 목표    | 고객 만족             | 고객 만족          |
| 관리대상  | 제품 또는 서비스 품질 요구사항 | 자동차 관련 품질 요구사항 |

\*출처: 한국생산성본부 인증원(2021), NICE평가정보(주) 재구성

동사의 2021년 3분기 보고서에 따르면, 총 111명의 임직원이 근무하고 있고, 이중 여성 근로자가 43명(38.73%)이고, 기간제 근로자는 보유하고 있지 않으며, 평균 근속 년수는 각각 3년 이상으로 확인된다.

표 7. 여성/기간제 근로자 근무 현황

| 사업 부문 | 성별 | 정규직 | 기간제 근로자 | 총합 | 평균 근속년수 |
|-------|----|-----|---------|----|---------|
| 전체    | 남  | 68  | -       | 68 | 3년 7개월  |
|       | 여  | 43  | -       | 43 | 3년 4개월  |

\*출처: 3분기 보고서(2021), NICE평가정보(주) 재구성

지배구조 부문은 정관에 의해 주주의 의결권을 1주마다 1개로 정하고 있으며, 정기/임시 주주총회 시 전자투표제를 운영하고 있지 않으며, 총 4명의 이사 중 1명의 사외이사를 보유하고 있다. 이사는 주주총회에서 선임하고, 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 출석한 주주 의결권의 과반수로 선임 여부를 정하고 있어, 이사 선정의 공정성을 확립하고 있다. 또한, 계열회사 지분 표를 공시함으로써 지배구조 정보를 공개하고 있는 것으로 보인다.

동사는 이사회 내 감사위원회를 별도로 운영하고 있지 않고, 상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있다. 동사의 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있고, 제반업무와 관련된 장부 및 서류를 해당 부서에 요청할 수 있으며, 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적합한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있는 권한을 갖는 등 감사 활동에 대한 독립성이 보장되어 있다.

## ■ 증권사 투자의견

| 작성기관  | 투자의견 | 목표주가 | 작성일 |
|---|------|------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 최근 6개월 이내 발간 보고서 없음</li> </ul> |      |      |     |

## ■ 시장정보(주가 및 거래량)



\*출처: Kisvalue(2021.11)